

招待会社名 Invited by

電子機器2026

トータルソリューション展

2026.6.10-12 Wed.~Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト東展示棟・会議棟

完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場!

事前登録のうえ、来場者パッジを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のパッジホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

来場登録はこちらのWEBから www.jpccashow.com/ 招待状

入場料: 1,000円(税込) WEB登録にて無料

www.jpccashow.com

事前来場登録のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願いいたします。本招待状のみでは入場できませんのでご注意ください。

STEP.1

公式ホームページより来場登録へお進みください。

STEP.2

ご設定するメールアドレス宛に、本人確認メールが届きます。30分以内に認証コードを入力し、パスワードの設定を完了してください。設定済みのメールアドレスでの複数登録はできません。

STEP.3

展示会当日、来場者マイページより来場者パッジをプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。パッジホルダーをピックアップいただき、来場者パッジを中に入れて、会場入口にてバーコードをご提示ください。

事前登録/最新情報はHPをご覧ください

開催概要

JPCA Show 2026
第55回 国際電子回路産業展

JIEP 2026
マイクロエレクトロニクス
第40回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展

AI Device Expo WIRE Japan Show 2026

Electronics Component & Unit Show

E-Textile/Wearable

半導体産業展

OSAT

電子機器トータルソリューション展 基調講演 無料 事前登録

東7ホール 基調講演会場

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

10:30-11:20 11:30-12:20 13:00-14:00

半導体産業は2030年に200兆円の巨大市場を構築する! ~AIインフラの凄まじさ、後工程・基板が重要ななる展開

AI時代を支えるフラッシュメモリ戦略と次世代製造

特別講演 PCB産業の動向 - 日本企業のとるべき道

半導体産業展 特別講演 無料 事前登録

東7ホール 半導体産業展特別講演会場

6月11日(木) 6月12日(金)

13:00-13:50 14:20-15:10 15:40-16:30

半導体政策に見る日本経済復活の道筋

半導体の世紀

日本の半導体産業の将来に向けて

九州半導体の現在と産業界(SIIQ)の取り組み

半導体産業における最新トピックス

日本の半導体産業の将来に向けて

JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料 事前登録

会議棟6F 最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

10:00-12:30 10:00-12:30 10:00-12:30

A会場(会議棟605・606) B会場(会議棟607・608)

10A-1 Beyond5Gに向けた高速通信用途向け基板材料の開発動向

10A-2 Beyond5G向け低伝送損失/低熱膨張基板材料の開発動向

10A-3 最新 PTFE 多層 PCBソリューションと超低 Dk・Df の PTFE 低損失材料

10A-4 高周波・高速伝送を支える先端配線板&モジュール

10A-5 光に切り替わる AI時代のプリント配線板と必要とされる材料について

10A-6 プリント配線板の技術動向と高周波・高速伝送に向けた取り組み

10A-7 ミリ波帯アンテナ一体型モジュール技術と6Gに向けた取り組み

11A-1 高機能・高密度化を実現する配線板製造技術

11A-2 次世代SAP対応無電解めっき開発とナノボイド解析

11A-3 メックの異方性エッチング技術による高密度配線の実現

11A-4 先端パッケージにおける露光技術の現状と展望

11A-5 進化するパッケージ基板・インナーボーザ

11A-6 チップレット集積技術の最新動向

11A-7 フリップチップ・パッケージにおける放熱の課題とそれに対する取り組み

11A-8 半導体パッケージ基板向け層間絶縁材料と加工技術の開発について

12A-1 応用広がる3次元実装技術の最新動向

12A-2 3D集積技術の進化と産業展開 - 技術潮流と今後の方向性 -

12A-3 3次元積層技術を用いた3Dフラッシュメモリデバイスの技術動向、技術課題と取り組み

12A-4 CMOSイメージセンサにおける3次元実装技術

12A-5 チップレット/3D構造を実現するインターコネクション技術

12A-6 WOW/COWハイブリッドプロセスを用いた3次元集積システム(仮)

12A-7 チップレット/3D構造を実現するインターコネクション樹脂技術 -ポリマーハイブリッド接合・転写/Fusion接合・再配線、放熱、シーリング-

12A-8 エキシマレーザーを用いた次世代実装技術及びパッケージ基板・RDL加工の最新技術革新

10B-1 光電融合技術: Co-Packaged Opticsの最新動向

10B-2 加速する光化: Co-Packaged Opticsの最新動向と実装技術

10B-3 高性能で高効率な次世代AIファクトリーを実現するための最先端実装技術とその効果

10B-4 半導体の経営戦略を探る

10B-5 AIの急速な進化が、半導体の技術進化を加速させる

10B-6 衝撃の半導体市場・ダイナミズム・マーケティング・メトリクスで読み解く

10B-7 半導体の経営戦略を探る

11B-1 Meid・イン・ジャパンの挑戦: チップレット技術が拓く新次元への道

11B-2 The Future of Advanced Package for AI Application

11B-3 AIの進化に不可欠な先端パッケージング技術

11B-4 モノづくりの力で実現する宇宙産業の変革

11B-5 未定

11B-6 電動車(xEV)におけるパワー半導体・受動素子・冷却機構実装技術最新動向

11B-7 フィジカルAI時代におけるチップレットパッケージ - パネルサイズ製造への期待

12B-1 最新パッケージにおけるサプライチェーン動向 - 日本が技術の中心に、供給のボトルネックに -

12B-2 Cloud AI時代のメガパッケージと材料・装置・プロセスの最新展開

12B-3 最新のヘテロジニアス・インテグレーションとガラス・サブストレートの開発状況

12B-4 加速するガラスサブストレート技術開発の最新動向

12B-5 最新のヘテロジニアス・インテグレーションとガラス・サブストレートの開発状況

12B-6 加速するガラスサブストレート技術開発の最新動向

12B-7 AIデータサーバー向けガラスサブストレート

JPCA 賞 (アワード)

優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術の進歩発展を図っている出展者を表彰します。

6月10日(水) 16:40~17:00 東7ホール セミナー会場7

半導体オプ・ザ・イヤー2026 受賞製品・技術発表

6月10日(水) 14:00~(受付開始13:30~) 東7ホール セミナー会場10

アカデミックプラザ表彰式

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示委員会にて優秀な論文内容を選考し、アカデミックプラザ賞受賞者を決定いたします。

6月10日(水) 16:40~17:00 東7ホール セミナー会場9

JISSO PROTEC 特別講演 無料 事前登録

東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

10:30-11:20 10:30-11:20 10:30-11:20

スマートフォン・周辺機器、Apple製品、AIサーバーの業界見通し

規格カイゼン提案による電子部品の品質向上への取組み

2026年度版 JEITA 実装技術ロードマップの紹介 ~実装設備の最新動向~

PROTEC セミナー 無料 事前登録不要

東1ホール PROTEC セミナー会場

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

11:45-12:30 12:55-13:40 14:05-14:50 15:15-16:00

光電融合・先端PKG実装を切り拓く精密液体制御技術

一自律生産の実現を目指す Fujii Smart Factory の進化

実装工程の品質を飛躍的に向上!最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法

実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026

コンパクトという選択 - 新実装機 CLT-FG

SMT検査工程の省人化を実現する最新AI活用ソリューション

【事例から読み解く】部品挿入工程の自動化と技術ポイント

実装工程の品質を飛躍的に向上!最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法

実装境界ゼロ始動 - 世界初!016008実装、その本質は「あらゆる実装品質の証明」にある

実装工程の品質を飛躍的に向上!最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法

実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026

パワー半導体分野における実装技術トレンド

PWB コンサルタントによるセミナー 有料 事前登録

会議棟609

6月10日(水) 6月12日(金)

11:00-12:00 12:30-13:30 14:00-15:00 15:30-16:30

多層リジッドプリント配線板の製造方法 初級~中級編

基板の環境対応について技術営業セミナー

プリント配線板における実装技術 初級編

プリント配線板の品質保証 初級~中級編

プリント配線板の品質・製造技術 ~こまごとの解決に向けて①回路形成~

プリント配線板の品質・製造技術 ~こまごとの解決に向けて②印刷~

プリント配線板のめっき技術 ~無電解めっきと電気めっきの基礎~

セットメーカー向け ~あとから困らない印刷配線板の調達~

来場者参加型企画

ブースコンテスト 展示会オリエンテーション&ツアー

ブースコンテストを今年も開催!イキデザイン賞・特別賞が皆様投票で決定します。

学生の皆様に向け、オリエンテーションを開催し、終了後ツアーを実施します。

JISSO PROTEC 特別講演 無料 事前登録

東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

10:30-11:20 10:30-11:20 10:30-11:20

スマートフォン・周辺機器、Apple製品、AIサーバーの業界見通し

規格カイゼン提案による電子部品の品質向上への取組み

2026年度版 JEITA 実装技術ロードマップの紹介 ~実装設備の最新動向~

PROTEC セミナー 無料 事前登録不要

東1ホール PROTEC セミナー会場

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

11:45-12:30 12:55-13:40 14:05-14:50 15:15-16:00

光電融合・先端PKG実装を切り拓く精密液体制御技術

一自律生産の実現を目指す Fujii Smart Factory の進化

実装工程の品質を飛躍的に向上!最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法

実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026

コンパクトという選択 - 新実装機 CLT-FG

SMT検査工程の省人化を実現する最新AI活用ソリューション

【事例から読み解く】部品挿入工程の自動化と技術ポイント

実装工程の品質を飛躍的に向上!最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法

実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026

実装境界ゼロ始動 - 世界初!016008実装、その本質は「あらゆる実装品質の証明」にある

実装工程の品質を飛躍的に向上!最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法

実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026

パワー半導体分野における実装技術トレンド

ダントツものづくりセミナー 無料 事前登録不要

東7ホール セミナー会場8

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

13:00-13:45 13:45-14:30 14:35-15:20 15:20-16:05

生産性向上のつくりDX 特別セッション

TOC/管理会計セッション

13:00-13:45 【特別基調講演】DX時代の地域スクール/JPCAものづくりアカデミー

13:45-14:30 【特別講演3】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

13:45-14:30 【特別基調講演】資金・人手不足、原材料高騰の中での電子回路業界活性化は生産性向上しかない!

14:35-15:20 【特別講演1】2026年後半の日本経済・産業

15:20-16:05 【特別講演2】2027年の経済・産業展望

13:00-13:45 【特別講演7】電子回路ものづくり企業の「現場改善」について「お金の良い流れ」から考える

13:45-14:30 【特別講演4】月曜日が楽しいみな会社にしよ! ~全体最適のマネジメント理論TOCとは~

14:35-15:20 【特別講演5】トヨタ式現場管理

15:20-16:05 【特別講演6】現場改善のJコスパ理論による強化策(ROA)

13:00-13:45 【特別講演8】経営者は何を管理すれば現場改善効果を見える化できるのか【現場改善大会】(KCC)

13:45-14:30 【特別講演9】JPCAものづくり大賞/準大賞受賞(2024年度)改善取組事例報告4件

14:35-15:20 【特別講演10】JPCAものづくりアカデミー校長、千住金工業 千住金工業 千住金工業

15:20-16:05 【特別講演11】JPCAものづくりアカデミー校長、千住金工業 千住金工業 千住金工業

JIEP アカデミックプラザ 無料 事前登録不要

東7ホール セミナー会場9

6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

13:00-13:20 13:20-13:40 13:40-14:00 14:00-14:20 14:20-14:40 14:40-15:00 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 16:20-16:40 16:40-17:00

プリント基板のCuダイレクレーザ加工における線幅粗調整の最適化

低温ヘテロジニアス集積のためのAu薄膜転写を応用した接合面の平滑化およびマイクロパターンの研究

USB2.0通信の電磁的情報漏洩実験の構築と盗聴防止を目的とした漏洩メカニズムの解明

回路ハードウェアに対する深層学習サイドチャネル攻撃耐性評価の効率化に向けた検討

サイドチャネル攻撃対策AES暗号のFPGA実装と深層学習攻撃耐性の評価

ITO薄膜を用いた第6世代移動通信システム用GHz帯透明電磁シールドの検討

熱伝導性を含む接続特性向上とマイクロファイバ低温焼結促進のための臨場式エポキシ樹脂バインダの配合設計

動的パーコレーション誘導を用いた3D印刷配線の低抵抗に対するバインダ化学的役割

銅系導電ペーストの材料設計による金属電極界面の電気接続安定化

金属製松葉利用時の人体適性による伝送特性劣化低減の検討

液体金属配線 - 印刷電極界面の反応挙動と接続抵抗の安定性評価: ストレッチャブル回路構築に向けて

マルチマテリアルに向けた金属ナノ・金属・樹脂の精密接合

表皮効果損失抑制のための負透磁率材料を用いた円形積層伝送線路に関する研究

ソフト3Dエレクトロニクス技術により試作した光るクラゲ

デザイン思考による見た目の形状変化を活用したPOPディスプレイシステムの開発

メカニカルフリー-液晶レンズ技術が実現する産業応用

半導体産業に向けた低温焼成接合を可能とする銅ナノ粒子系

種積を用いたPFASフリーの水現像型ボジ・ネガフォトリソの開発

水平台機構と光を用いた鳥類急避システム

スイッチング電源など閉回路の導線内循環電流について

マルチマテリアルに向けた金属ナノ・金属・樹脂の精密接合

化学物質伝達ツール解説セミナー 無料 事前登録不要

東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月12日(金)

13:30-14:30 15:00-16:00

CMPの全体解説と今秋運用開始に向けて

自動車向け化学物質伝達ツールIMDS活用の概説

デモンストレーション/体験 東7ホール 特設会場

あなたの足、ちゃんと踏ん張れますか?

転倒予防の指標「足指持ち」を30秒で測定! 結果判定やトレーニングゲームもできる体験型ツール HAJICHECK (ハジチェック) をぜひお試しください。

技術提供: 東ニッコ

ご挨拶

※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早めの受付にご協力をお願いいたします。

